

中国半导体产业链市场深度调研报告 (2009-2010年)

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《中国半导体产业链市场深度调研报告（2009-2010年）》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201111/78764.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

正文目录

第一部分 基础篇 14

第一章 半导体产业概述 14

1.1 全球半导体产业概述 14

1.1.1 全球半导体产业发展历程 14

1.1.2 全球半导体产业景气循环 18

1.1.3 半导体产业在现代国民经济中的重要地位 23

1.1.4 半导体产业关联度分析 24

1.2 中国半导体产业概述 25

1.2.1 中国半导体产业发展历程 25

1.2.2 中国半导体产业市场概述 26

1.3 半导体产业链结构 28

1.4 半导体产品分类 28

1.5 半导体制造流程 28

1.6 半导体集成电路类别 30

第二章 全球及中国半导体市场分析 33

2.1 全球半导体市场分析 33

2.1.1 全球半导体市场分析 33

2.1.2 全球半导体应用领域分析 33

2.1.3 全球半导体资本支出分析 34

2.1.4 全球半导体产能分析 34

2.1.5 2005全球半导体主要厂商排名 35

2.1.6 2006全球主要半导体厂商投资分析 37

2.2 2005-2006中国半导体市场分析 39

第二部分 产业链篇 42

第三章 全球及中国IC设计市场分析 42

3.1 IC设计行业概述 42

3.1.1 IC设计行业特点 42

3.1.2 IC设计流程	44
3.1.3 IC设计方法演进路线	46
3.1.4 SOC主要特性及关键技术	47
3.1.5 IC设计业务模式	49
3.1.6 IC设计竞争力影响因素	49
3.2 全球及中国IC设计行业发展概述	50
3.2.1 全球IC设计行业发展概述	50
3.2.2 中国IC设计行业发展概述	53
3.3 中国IC设计业SWOT分析	53
3.3.1 中国IC设计业优势（S）	53
3.3.2 中国IC设计业劣势（W）	54
3.3.3 中国IC设计业威胁（T）	55
3.3.4 中国IC设计业机会（O）	56
3.4 中国IC设计行业分市场分析	56
3.4.1 中国消费类IC设计市场分析	56
3.4.2 中国通信IC设计市场分析	57
3.4.3 中国工业控制类IC设计市场分析	58
3.5 中国IC设计厂商分析	61
3.5.1 大唐微电子	61
3.5.2 杭州士兰	62
3.5.3 中星微	63
3.5.4 珠海炬力	64
3.5.5 中国华大	66
3.5.6 南山之桥	66
3.5.7 北京北大众志	67
3.5.8 北大青鸟集成电路	70
3.5.9 北京海尔集成电路	70
3.5.10 北京华虹集成电路	71
3.5.11 北京畅讯科技	72
3.5.12 北京东世科技	73
3.5.13 北京弗赛尔	73
3.5.14 北京格林威尔	74

3.5.15 北京宏思电子 76

3.5.16 北京科泰康 77

3.5.17 北京明宇科技 78

3.5.18 北京思旺电子 80

3.5.19 北京微辰 82

3.5.20 北京协同伟业 82

3.5.21 北京芯晟 83

3.5.22 北京兆日科技 84

3.5.23 北京正有 85

3.5.24 北京智源利 87

3.5.25 北京东科微电子 88

3.5.26 北京方舟 89

3.5.27 北京福星晓程 90

3.5.28 硅谷数模 91

3.5.29 北京火马 93

3.5.30 北京六合万通 93

3.5.31 北京中庆微 94

3.5.32 北京奇普嘉 95

3.5.33 北京神州龙芯 96

3.5.34 北京清华同方微电子 97

3.5.35 北京润光泰力 98

3.5.36 威盛电子 99

3.5.37 上海复旦微电子 99

3.5.38 上海富士通微电子 101

3.5.39 艾迪悌新涛 101

3.5.40 上海得理 102

3.5.41 上海鼎芯 103

3.5.42 上海凯明信息 104

3.5.43 上海富瀚 105

3.5.44 上海华邦 105

3.5.45 上海华龙 105

3.5.46 上海交大汉芯 107

3.5.47 上海明波 108
3.5.48 上海奈米闪芯 108
3.5.49 上海胜德 109
3.5.50 上海微科 109
3.5.51 上海矽创 110
3.5.52 上海芯成 110
3.5.53 上海芯华 111
3.5.54 上海芯原 112
3.5.55 上海新茂 112
3.5.56 上海智芯科 113
3.5.57 上海智原科技 113
3.5.58 上海展讯 114
3.5.59 上海德律风根 115
3.5.60 上海华亚微电子 116
3.5.61 上海京西电子 116
3.5.62 上海力通微 116
3.5.63 上海扬智 117
3.5.64 晶门科技 119
3.5.65 埃派克森 120
3.5.66 深圳剑拓科技 121
3.5.67 深圳艾科创新 122
3.5.68 深圳爱思科 122
3.5.69 深圳爱芯 123
3.5.70 深圳国微 123
3.5.71 深圳海思 124
3.5.72 深圳美芯 126
3.5.73 深圳芯邦微电子 127
3.5.74 深圳中颖 127
3.5.75 希格玛晶华 128
3.5.76 安凯开曼 129
3.5.77 厦门联创 129
3.5.78 广州精芯 130

3.5.79 成都国腾	131
3.5.80 成都华微	132
3.5.81 成都威斯达	133
3.5.82 四川虹微	134
3.5.83 艾博科技	134
3.5.84 苏州国芯	136
3.5.85 苏州华芯	136
3.5.86 苏州世宏	137
3.5.87 江苏意源	138
3.5.88 杭州国芯	139
3.5.89 绍兴芯谷	140
3.5.90 无锡爱芯科	141
3.5.91 无锡亿晶	141
3.5.92 无锡盈泰	142
3.5.93 中电55所	142
3.5.94 西安联圣	143
3.5.95 西安深亚	145
3.5.96 飞思卡尔	146
3.5.97 重庆西南集成	148
3.6 中国IC设计投资分析	149

第四章 全球及中国IC制造市场概述 153

4.1 2005-2006全球IC制造市场概述	153
4.2 2005-2006中国IC制造市场概述	154
4.3 全球及中国主要IC制造厂商分析	154
4.3.1 全球主要IC制造厂商	154
4.3.1.1 台积电	154
4.3.1.2 台联电	159
4.3.1.3 新加坡特许半导体	159
4.3.2 中国主要IC制造厂商	160
4.3.2.1 中芯国际	160
4.3.2.2 华虹	161

4.3.2.3 上海宏力	166
4.3.2.4 上海新进	167
4.3.2.5 江苏和舰	168
4.3.2.6 上海先进	169
4.3.2.7 珠海南科	169
4.3.2.8 中纬积体	171
4.3.2.9 首钢日电	171
4.3.2.10 华越微电子	172
4.3.2.11 华润微电子	172
4.3.2.12 无锡友达	173
4.3.2.13 安博电子	174
4.3.2.14 西岳电子	175
4.3.2.15 柏玛微电子	175
4.3.2.16 其它晶圆厂	176
4.4 全球四大晶圆厂对比分析	177
4.4.1 全球四大晶圆代工厂经营状况比较	177
4.4.2 全球四大代工厂商代工厂比较	178
4.5 小结	180

第五章 2005-2006全球及中国IC封测市场分析 181

5.1 IC封测概述	181
5.1.1 IC封测概述	181
5.1.2 主要IC封装技术比较	181
5.1.3 IC封装发展趋势	184
5.2 全球IC封测概述	186
5.3 中国IC封测概述	187
5.4 中国主要IC封测厂商	190
5.4.1 江苏长电	190
5.4.2 北京自动测试技术研究所	191
5.4.3 南通富士通微	193
5.4.4 华越芯装	193
5.4.5 乐山菲尼克斯	194

5.4.6 宁波明昕 195

5.4.7 天水华天 196

5.4.8 北京微电子技术研究所 197

第六章 全球及中国半导体设备市场分析 198

6.1 半导体设备行业概述 198

6.2 世界半导体设备市场分析 199

6.3 中国半导体设备市场分析与预测 199

6.4 中国半导体二手设备市场分析 199

6.5 中国半导体设备主要厂商分析 204

6.5.1 七星华创 204

6.5.2 铜陵三佳电子 205

6.5.3 中电45所 206

6.5.4 中电48所 207

6.5.5 西北机器厂 210

6.5.6 兰州兰新 211

6.5.7 北京中科信 212

6.5.8 沈阳芯源 213

6.5.9 青岛旭升 214

6.5.10 商巨科技 214

6.5.11 上海微高 215

6.5.12 上海依然 215

6.5.13 成都南光 216

6.5.14 汉唐科技 217

6.5.15 江苏苏净 217

6.5.16 爱德万 218

6.5.17 泰瑞达 218

6.5.18 AEHR老化系统公司 219

6.5.19 科利登 220

6.5.20 东京精密 221

第七章 全球半导体原材料市场分析 223

7.1 半导体原材料行业概述	223
7.2 全球半导体原材料市场分析	224
7.3 中国半导体原材料市场分析	225
7.4 中国半导体原材料主要厂商分析	231
7.4.1 有研硅股	231
7.4.2 上海合晶	231
7.4.3 万向硅峰	232
7.4.4 宁波立立	233
7.4.5 洛阳单晶硅	234
7.4.6 峨嵋半导体	235
7.4.7 浙大海纳	237
7.4.8 国瑞电子材料有限公司	238
7.4.9 北京化学试剂研究所	239
7.4.10 中电华威	241
7.4.11 有研亿金	242
7.4.12 河北普兴电子材料有限公司	243
7.4.13 贺利氏招远贵金属材料	243
7.4.14 上海申和热磁	244
7.4.15 乐山新光	245
7.4.16 上品综合	245
7.4.17 宁波东盛集成电路元件厂	246
7.4.18 河北晶龙	246
7.4.19 广州半导体材料研究所	248
7.4.20 广州爱斯佩克	249
7.4.21 上海光刻电子	249
7.4.22 苏州瑞红	249
7.4.23 长沙韶光	252
7.4.24 厦门永红电子有限公司	253
7.4.25 宁波康强	253

第三部分 发展篇 256

第八章 中国半导体产业区域分析 256

8.1 长江三角洲	256
8.1.1 上海	256
8.1.2 江苏	257
8.1.3 浙江	266
8.2 京津环渤海湾	268
8.2.1 北京	268
8.2.2 河北	269
8.2.3 山东	273
8.2.4 辽宁	274
8.2.5 天津	277
8.3 珠江三角洲	279
8.3.1 深圳	279
8.4 西部地区	280
8.4.1 西安	280
8.4.2 四川	281
8.4.3 重庆	282

第九章 中国半导体产业环境分析 283

9.1 中国半导体产业投融资环境分析	283
9.2 中国半导体产业政府政策分析	283
9.2.1 全球主要国家半导体产业政策分析	283
9.2.2 中国半导体产业政策分析	287
9.3 中国硅知识产权（IP）产业分析	287
9.3.1 IP产业概述	287
9.3.2 IP基本概念与相关流程	288
9.3.3 IP市场前景分析	288
9.3.4 中国IP行业存在的主要问题	289
9.3.5 中国IP行业最新进展	294
9.3.6 中国IP产业调查	299
9.3.7 小结	302

第十章 执行总结 304

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201111/78764.html>